罗工讲解的内容记录如下：

三种专用设备，不是通用设备：

1. 耦合盒子（简单）（封装设备）（BOX封装耦合）
   1. 夹爪
   2. 透镜
   3. FA（um级的精度）
   4. 点胶（唯一手动的过程）
   5. 紫外灯固化
2. 芯片测试台（最简单）
   1. 发光机构
   2. 被测芯片
   3. 光谱分析仪
   4. 滑台粗对准，精度要求不高
   5. 侧面进光
3. 老化设备
   1. 高温
   2. 高电流
   3. 长时间
4. 光芯片测试台（偏手动，因为不同的芯片有不同的程序，所以没有固定程序）（硅光芯片测试）
5. 晶圆测试台（硅光晶圆测试）（难度大，测项多）
   1. 顶部测试

数据处理：直线度，kink点（平滑度），阈值电流（刚开始发光时的电流）。一般由客户提供。如果很简单的，我们就自己实现。客户自己处理自己的数据，因为各家标准不一样。

软件分为：机台软件（运动控制、机器视觉）、测试软件（仪器仪表）。他们之间通过TCP通讯。